

PWB用多機育成線システム
鈴木 康晴, 鶴嶋 昭司, 泉 正夫, 野尻 寛, 植村 昌俊
(沖電気工業株式会社)

1. まえがき

PWBの配線においては、一般に線分探索法⁽¹⁾⁽²⁾と迷路法⁽³⁾とを組合せたものが広く用いられている。線分探索法は、図1に示すように、あらかじめ定められた配線格子上に、端点S及びTより障害物を認識しながら仮想線分(腕という)を発生させ、端子間の経路を探索していくものである。

迷路法は、図2に示すように、あらかじめ定められた配線格子上(セル)に波を発生させ、障害物を認識しながら経路の探索を行なう。これらの2つの手法の共通点としては、既に配線されたパターンが次に配線する端点間の障害物となることである。

のことから、配線順序により配線率が左右される問題が生じる。このような問題の改良手法として、配線順序を、配線が進むにつれて逐次決定していく手法⁽⁴⁾や、配線パターンの経路の位置をあらかじめ概略的に決め、配線しようとしている端点間の経路探索時には、配線パターンを変更する手法⁽⁵⁾などが提案されている。

筆者らも後者の考え方によって、1982年に、線分探索法及び迷路法をベースに、配線パターンをある限られた

範囲内で、移動可能な障害物として扱いながら経路の探索を行なう“トラックフローティング手法⁽⁶⁾”を考案し、

(1) 複数種の部品ランド径

(2) 複数種のパターン幅

(3) 浮動via方式

についても配線が可能な自動配線システムを開発した。

今回、高配線率を実現するため、トラックフローティング手法(以下、TF手法と呼ぶ)のモデルを精査化及び体系化するとともに、

(4) ミリ系部品

の配線も可能となるように改良した。

本文では、線分探索法上を中心にして、(1)～(4)の配線手法を紹介する。

2. 基本アルゴリズム

先ず、TF手法の基本的な配線モデルについて示す。

(a) 配線格子

一般的な線分探索法の場合は、あらかじめ、パターン間の間隙を考慮した格子を配線格子として定義し、配線パターンはこの格子上を走行する。TF手法では、図3に示すように、部品ピンのピッチに合せた格子を基本格子

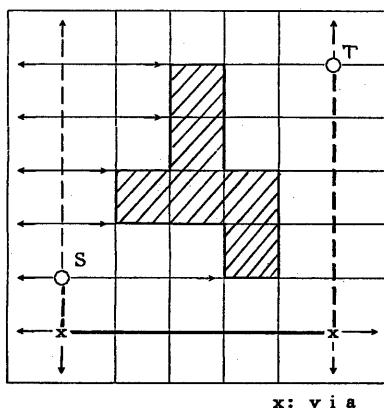


図1 線分探索法

6	5	6	7				
5	4	5				T	
4	3	4					
3	2					7	
2	1	2	3			6	7
1	S	1	2	3	4	5	6
2	1	2	3	4	5		

図2 迷路法

と呼び、基本格子内をいくつかに分割し、これをトラックと呼ぶ。配線格子は、この基本格子とトラックの2つを言う。配線パターンは、トラック内を第一優先で走行し、トラック内の配線パターンが一杯になった時点では基本格子上をも走行する。基本格子は、縦方向の配線層ではX軸、横方向の配線層ではY軸が基本格子となる。また、トラックの本数は、どの基本格子内も一律とする。

(b) 探索単位

一般的な線分探索法では、(a)で定められた配線格子の一本ずつを探索単位としているが、TF手法では、Via数削減の面から、着目基本格子とその両サイドの基本格子から成る領域を、探索単位としている。

例えば、図4のように、端点Sが存在する着目基本格子G3とその両サイドの基本格子G2, G4から成る領域が探索単位となる。

(c) 障害物の認識方法

一般的な線分探索法では、既に配線されたパターンは必ず配線格子に存

在している。そのため、障害物の認識は、配線格子が使用されているか否かで行なう。TF手法では、基本格子間で囲まれた配線領域は、トラック本数を配線容量としたCを持っており、パターンが配線されることにより、その配線パターンの容量分だけ減少するものと見なされる。そのため、障害物の認識方法は、端点より発生する仮想線分の必要容量 C_x と基本格子内の空きトラック容量 C_r の大小で判断する。

すなわち、 $C_r \geq C_x$ の場合は、仮想線分の発生が可能であり、 $C_r < C_x$ の場合は、仮想線分の発生は不可とみなす。

(d) 配線パターンのトラック割付

一般的な線分探索法では、経路が見つかった時点で配線格子が決定される。しかし、TF手法では、探索単位レベルの概略経路が見つかっても基本格子内の容量減少としてしか記憶されないため、配線パターンの探索単位内でのトラック位置は分らない。そのため、全ての探索が終了した時点で、トラックの割付が必要となる。

以上の配線モデルをもとに、図5の端点SからTへの、TF手法による配線アルゴリズムを以下に示す。

① 端点Sの下(左)側にある基本格子領域について、空き容量 C_r を算出し、 $C_r \geq C_x$ ならば、Sより仮想線分を発生する。

図5の例では、Y1とY2内に存在する配線パターンはP1, P2の2本であるが、P1, P2の始終点座標A, J, Iは、X軸上で重なっていないため、 $C_r > C_x$ となるので、仮想線分が発生される。

② 基本格子に接している配線パターンと交差する点で、Sからの仮想線分を分割する。

例えば、Sが存在する着目基本格子

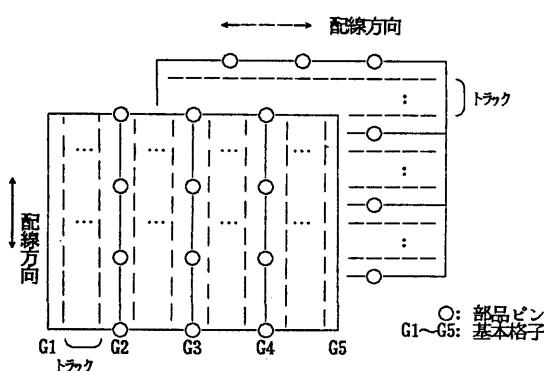


図3 配線格子

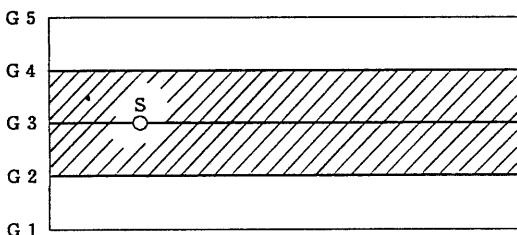


図4 探索単位

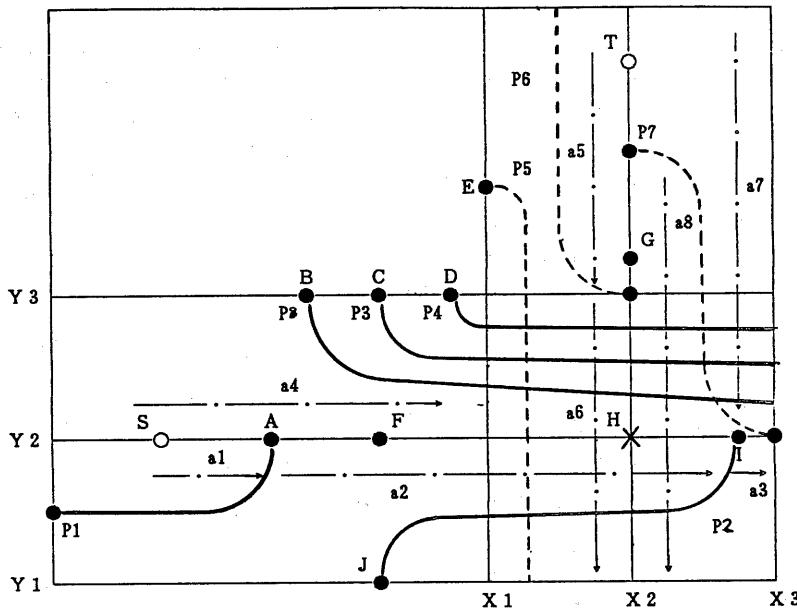


図 5 T F 手法の基本アルゴリズム

上の，AとIの点でそれぞれの配線パターンが接しているため，交差してしまう。そこで，AとIの点で仮想線分を分割し，a₁，a₂，a₃が求まる。

③ Sの上(右)側にある基本格子領域についても，①～②の処理を行い仮想線分を求める。図では，仮想線分a₄が求まる。

④ 探索領域内の仮想線分群(a₁，a₂，a₃，a₄)より，先ず，Sと連結する仮想線分a₁，a₄を両サイドの領域より抽出する。抽出された仮想線分a₁，a₄について，反対側の領域にある仮想線分のなかから，着目基本格子上の同一座標を共有する線分を選出する。さらに，このようにして選ばれた線分についても同様な手順で，連結する仮想線分群を選びだす。

図では，(a₁，a₂，a₄)が連結仮想線分群となる。

⑤ 求められた連結仮想線分群について，Tとの交点検出を行なう。交点が見つかなかった場合は，Sの縦方向について，①～④をくり返す。交点が見つかった場合は，⑧へ。

図では，Tと交差しないため，交点の検出は失敗となり，①へもどる。

⑥ 次に，Tについて，①～④の処理を行い，連結仮想線分群(a₅，a₆，a₇，a₈)が求まる。

⑦ Tの連結仮想線分群とSの連結仮想線分群とで交点の検出を行う。図では，双方の仮想線分が交差する点Hが求まる。

⑧ 検出された交点Hより，それぞれの端点S，Tへ，各々の連結仮想線分群の中から線分数が最小となるよう最終的な仮想線分を選びだす。

図では，仮想線分a₂→a₄，a₈→a₅を選び，S，Tが存在する基本格子上(Y₂，X₂)の交差する座標値

S, F, H, G, T とパターンの上下左右関係が求まる。

⑨ 全ての端点について、①～⑧を繰り返す。

⑩ 全端点の経路探索終了後、基本格子毎に、配線パターンを最終的なトラックへ割付る。

3. 空きトラック容量算出法の精査化

PWBに搭載される部品の取付けランドのサイズや、端点間を接続するパターンの幅は、複数種存在する。そのため、これらのサイズを考慮した経路探索を行うには、探索単位内にある障害物の占有容量 C_a 及び空きトラック容量 C_r を正確に管理する必要がある。

そこで、基本格子内トラック本数を C 、障害物（配線パターン又は部品ピンおよびVia）の占有トラック数の総和を C_a 、探索すべき系列のパターン又は、生成すべきVia占有トラック数を C_x としたとき、

$$C_r = C - C_a \geq C_x \rightarrow \text{通過可能}$$

$$C_r = C - C_a < C_x \rightarrow \text{通過不可}$$

ここで、

$$C_a = \sum_{i=1}^{n1} C_{li}/2 + \sum_{j=1}^{n2} C'_{xj}$$

$n1$: X (Y) 方向の探索の場合、同一 X (Y) 軸上にある探索範囲内のランド数

$n2$: X (Y) 方向の探索の場合、同一 X (Y) 軸上にある探索範囲内のパターンの本数

C_{li} : 部品ピン又はViaの占有トラック本数

C'_{xj} : 配線済パターンの占有トラック本数

(ただし、 $C_{li}/2$ は整数とする)

例えば、図6に示すように、配線パターン P_1 ($C'_{x1}=3$) は、基本格子上の E_1 の範囲を走行し、 P_2 ($C'_{x2}=1$) は、基本格子内を走行している。また E_2 の範囲に大小2つのランド L_1 , L_2 ($C_{l1}=1, C_{l2}=3$) が、基本格子上に存在している。このとき、A系列 ($C_x=1$) の経路探索をする場合、 E_1 では P_1 , P_2 が既に配線されているため、 $n1=0, n2=2$ となり、

$$C_a = (C'_{x1}/2) + C'_{x2} = 1 + 1 = 2$$

ただし、基本格子上を走向する配線パターンについては、 $C'_{xj}/2$ の整数とする。

従って、

$$C_r = C - C_a > C_x$$

となり、さらに E_2 では $n1=2, n2=1$ となり、

$$C_a = (C_{l1}/2 + C_{l2}/2) + C'_{x2} = 1 + 0 + 1 = 2$$

従って、

$$C_r = C - C_a > C_x$$

となる。以上より、全ての範囲で $C_r > C_x$ となり、A系列の仮想線分は、基本格子内を通過可能となる。

プログラム化の段階では、処理時間を節約するため、パターンとランド及びViaとの通過可能パターン本数の関係を配線の前段階で探索ルールとしてまとめ、経路探索時に容易に参照できるようにしている。

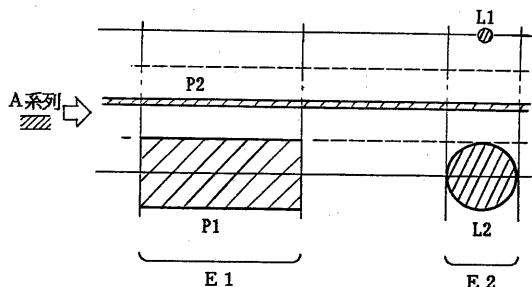


図6 空きトラック容量算出法

4. ミリ系部品の配線手法

TF手法の配線格子モデルは、インチ系部品又はミリ系部品のいずれか一方のピンピッチを基本格子と定めているため、インチ系部品とミリ系部品が混在した場合は、他方のピンが基本格子の交点上に存在しない場合がある。その結果、配線が不可能になる。

そこで、今回、次のような考え方をTF手法に導入した。“基本格子の交点上に存在しないピンを近傍の交点上に近似して配線を行なう。”この考えに従って、交点上に存在しない部品ピンについて、近似点までの引出しと基本アルゴリズムのトラック容量算出法を改良した。

図7の例で、この手法の手順を示す。

① 相手の端点Tとのマンハッタン距離が最短となるように、基本格子の交点上にSの近似点 s' （対応点と言う）を求める。

図7では、Tに最も近い点Dの位置が s' となる。

② 求められた s' とTについて、TF手法を用い s' より仮想線分を発生させ経路の探索を行なう。この際、部品のピンの占有容量 C_a を $C_a = C$ と見なす。

③ 経路が見つからなかった場合は、 s' をマンハッタン距離の短い順に再割付し、②を繰り返す。

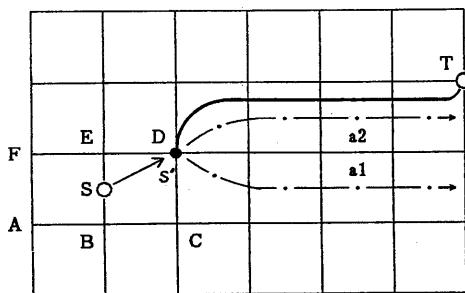


図7 ミリ系部品の配線手法

図7では、仮想線分 a_2 を選択した経路 $S \rightarrow s', s' \rightarrow T$ が求まる。

5. 浮動Via配線手法

Viaを基本格子上に限定したTF手法では、Viaネットが発生しパターンを走向させることができるにもかかわらず未結線となる場合がある。

例えば、図8のように、端点Sから発生した仮想線分 a_1 からは、Via生成可能位置が無いため、より高いレベルの仮想線分の発生ができず、TF手法では、SとTは未結線となる。

そこで、筆者らは、任意のトラックの交点上に、微少Viaを発生させることにより、さらに配線率を向上できると考え、TF手法完了後、微少Viaを用いた浮動Via配線を行っている。

その手順を次に示す。

① 先ず、基本格子とトラックの全てを格子表現したビットマップ上に、TF手法で割付けられた各々の配線パターンに対して、他の配線パターンとの位置関係より、配線通過禁止情報及び微少Via作成禁止情報をフラグとしてセットする。

② TF手法で未結線となった端点について、ビットマップ上のフラグがセットされていない空きビット上を、線分探索法を用い、経路探索を行なう。

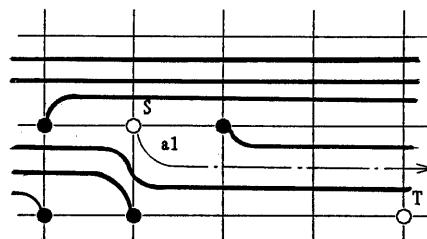


図8 浮動Via配線手法

6. 評価及び配線例

TF 手法での空きトラック容量算出法の精査化及び浮動 Via 採用の効果を評価するため、いくつかの実行例を示す。

表 1 は、基本アルゴリズムのみの場合と、空きトラック容量算出法の精査化後と、浮動 Via 配線手法を採用した場合の、それぞれの配線率の推移を示したものである。（各々の配線仕様を図 9 に示す。）

データ A・B の配線格子は、 110×80 基本格子（1 基本格子： $1/10$ インチ）であり、配線層は、2 層である。A の区間数（端子対）は 888 であり、B は 994 である。

表 1 に見られるように、空きトラック容量算出法の精査化の効果が極めて多い。これは、図 9 (b) に示すように、従来は微少 Via の部分での通過可能本数も、部品ピンの部分と同数であったが、容量算出法の精査化により、微少 Via の部分の通過可能本数が増大したためと考えられる。

浮動 Via 配線方法を採用することにより、1～2% 配線率が向上している。これは、TF 手法のみで配線した結果 Via ネックが生じたが、浮動 Via 配線方式を併用することにより Via ネックが解消したものと想定される。

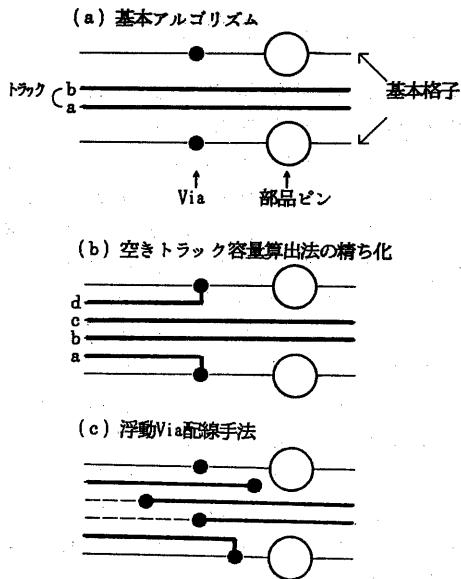


図 9 配線仕様

最後に、これらの各手法を用いた配線例を図 10, 11 に示す。図 10 は、IC ピン間 2 本、基本格子内のトラック本数を 4 本とし、Via のサイズを微少 Via とした配線仕様であり、TF 手法と浮動 Via 配線手法を採用している。

配線結果は、99% であった。

図 11 は、ミリ系部品が搭載された PWB の配線例である。配線仕様は、IC ピン間 1 本、基本格子内のトラック本数を 3 本とし、Via のサイズは IC ピンと同じであり、TF 手法のみで配線している。配線結果は、98% であった。

表 1 配線率の推移

データ	区間数 (端子対)	TF 手法		浮動 VIA 配線手法
		基本アルゴリズム	空きトラック容量 算出法の精査化	
A	888	798 (90)	866 (22)	876 (12)
B	994	912 (82)	963 (31)	970 (24)

() 未結線数

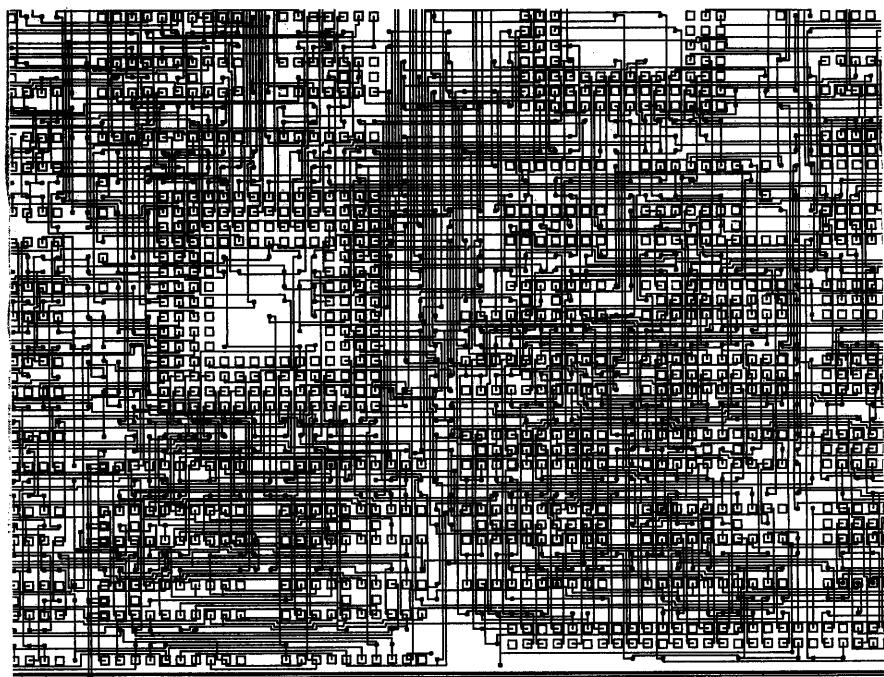


図 10 I C ピン間 2 本の配線例

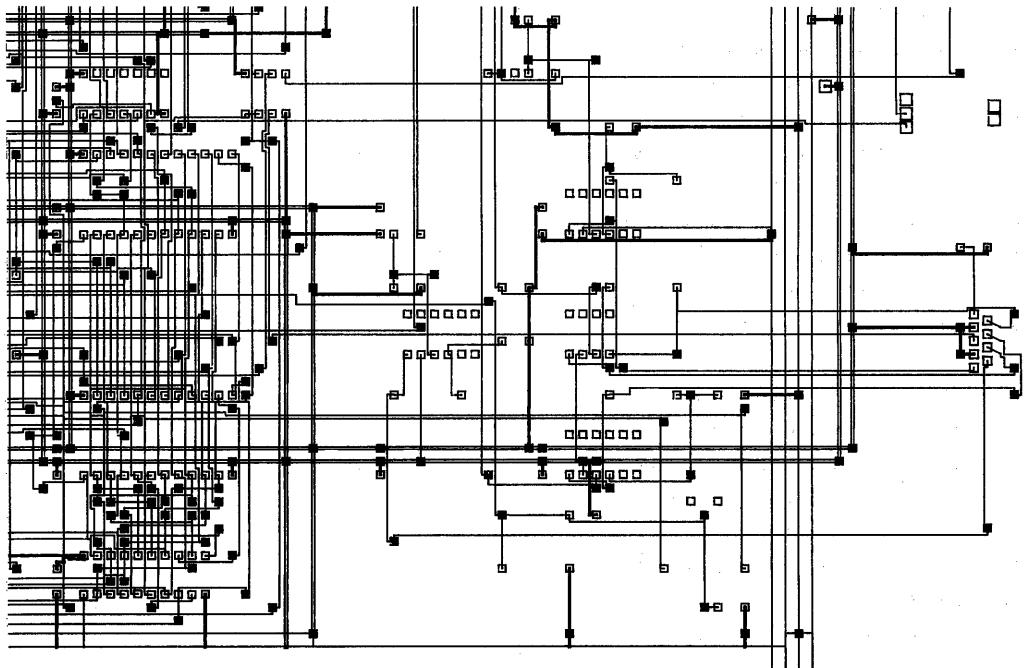


図 11 ミリ系部品の配線例

7. おわりに

T F 手法における空きトラック容量算出法，ミリ系部品の配線手法及び，浮動 Via 配線手法について述べてきた。

現在，各手法は，「C A D A S システム」の自動配線⁽⁷⁾に組み込み実用として使用されている。

謝 辞

終りに，各手法を開発するに当り御協力戴いた，当社 D A 推進部 渡会 隆志，上田 勤課長を始め，関係者各位に感謝致します。

- (6) 鈴木，上田他，‘高密度プリント基板自動配線の汎用化の一手法’情処学会，電子装置設計研究会資料，1982. 12-3
- (7) 鈴木，御嶽他，‘プリント基板設計システム（C A D A S）の会話型配線’情処学会第30回全国大会，1985. pp. 1897-1898

参考文献

- (1) K. Mikami, K. Tabuchi, ‘A computer program for optimal routing of printed circuit conductors.’ Proc. Information Processing ’68, 1969, pp. 1475-1478.
- (2) D. W. Hightower, ‘A solution to line routing problems on the continuous plane’ 6th Design Automation Workshop, 1969, pp. 1-24
- (3) Lee, C. Y., ‘An algorithm for path connections and its applications.’ IEEE Trans. Electronic Computers, 1961, pp. 346-365
- (4) J. C. Foster, ‘A “Lookahed” Router for Multilayer Printed wiring Boards’ 16th DAC, 1979, pp. 486-492
- (5) J. Soukup, ‘Global router’ 16th DAC, 1979, pp. 481-485